**课题大额支出情况说明**

**事由：**

陶耀宇课题组主持的国自然基金委优秀青年科学基金（海外）项目“基于先进器件的软硬件协同芯片架构设计”，课题的下一步目标是基于先进ReRAM存算一体器件IP进行芯片架构设计，并最终完成芯片流片制造，该目标需要ReRAM兼容的芯片流片服务。

**金额：**

课题组做了大量前期了解，目前ReRAM兼容的芯片流片服务市场价格约为5.00-8.00万元/mm2（台积电TSMC代理价格约为8.00万元/mm2、厦门UMC联芯代理价格约为6.00万元/套）。燕芯微电子（上海）有限公司提供了基于国产自主可控工艺的全套ReRAM兼容芯片流片服务，价格为5.00万元/mm2，在目前ReRAM兼容芯片流片服务价格中具有显著优势；预计流片芯片总面积为6mm2，总计30.00万元。

**拟出资来源：**

拟从纵向课题支出，项目名称全称为：基于先进器件的软硬件协同芯片架构设计，已到款140.00万元到课题组账户。

陶耀宇课题组

2025年8月6日